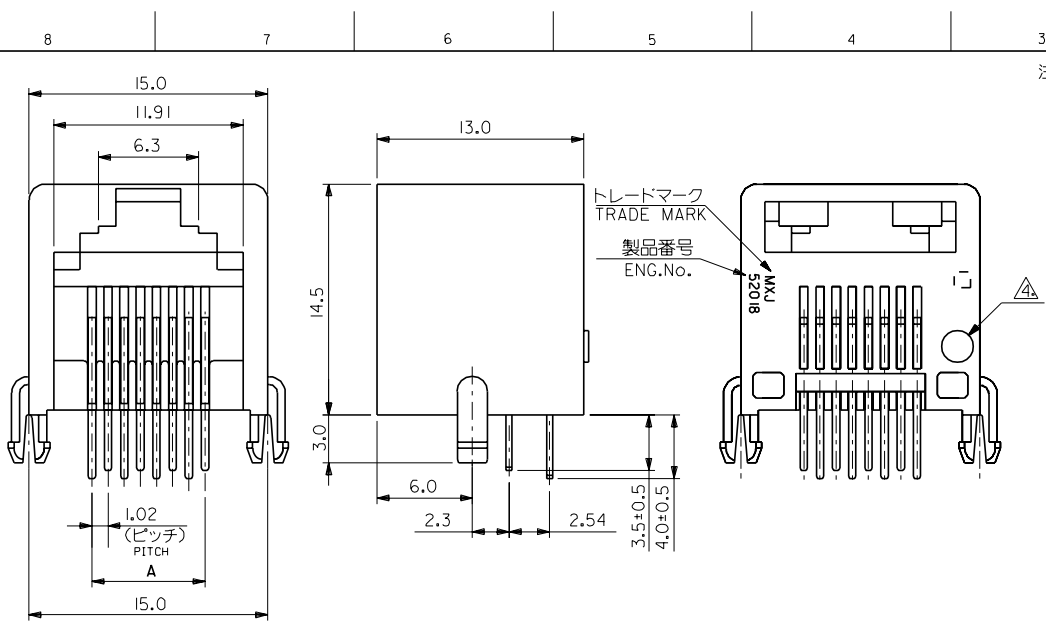
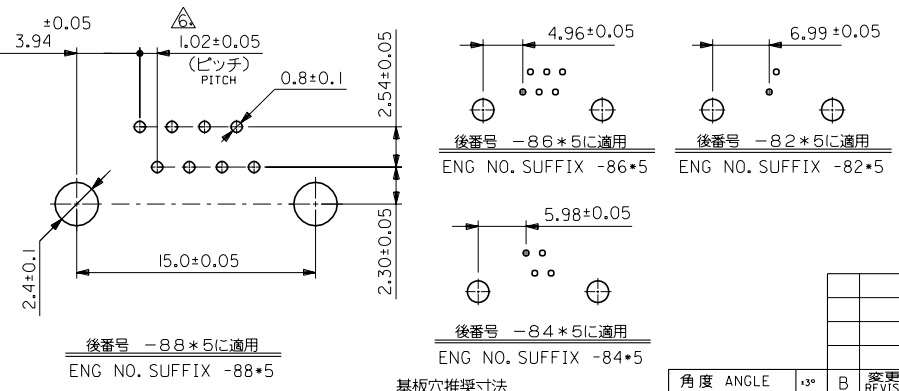


ENG. NO. SD-52018-8\*\*5  
EDP NO. #

MM DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING



- 注) NOTES
- 材質 MATERIAL  
ハウジング: ガラス入りポリエステル UL94V-0  
HSG. : POLYESTER G.F.15% UL94V-0  
ターミナル: リン青銅  
TERM. : PHOSPHOR BRONZE
  - メッキ仕様 PLATING  
接点部 : 金メッキ、表参照  
CONTACT AREA: GOLD PER TABLE  
半田付け部: 半田メッキ 1.0µmMIN.  
SOLDER AREA : TIN-LEAD 1.0µmMIN.  
下地メッキ: ニッケルメッキ 1.0µmMIN.  
UNDERPLATE : NICKEL 1.0µmMIN.
  - 推奨基板厚: t=1.6±0.05  
RECOMMENDED P.C.B. THICKNESS: 1.6±0.05
- △ 金メッキ厚標示  
COLOR CODING TO INDICATE GOLD PLATING  
黄色: 0.1µmMIN. 緑色: 0.38µmMIN.  
YELLOW : 0.1µmMIN. GREEN : 0.38µmMIN.  
オレンジ色: 0.76µmMIN. 無色: 1.27µmMIN.  
ORANGE : 0.76µmMIN. UNMARKED: 1.27µmMIN.
- ハウジングの色は、グレイ。  
HOUSING COLOR IS GRAY.
- △ 公差非累積。  
NON-ACCUMULATIVE



基板穴推奨寸法  
RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT  
(ジャック取付け側)  
JACK ASS'Y SIDE

8	7.11	1.27	52018-8845	
		0.76	-8835	
		0.38	-8825	
	6	5.08	1.27	-8815
			0.1	-8645
			0.1	-8445
2	1.02	1.27	52018-8245	

POSITION	CIRCUITS	(A)	金メッキ厚(µmMIN.) GOLD PLATING THK(MIN.)	製品番号 ENG. No.
材料 MATERIAL		注参照 SEE NOTES		MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社
仕上げ FINISH		注及び表参照 SEE NOTES AND CHART		
適用電線範囲 WIRE RANGE		—		EDP. NO. #
被覆外径 INS. RANGE		—		ENG. NO. SD-52018-8**5
DRAWN BY 95/10/30 CHK'D BY 95/3/8 M. Fukushima H. HIRAMOTO		DATE 95/10/30		TITLE 名称 MODULAR JACK HOUSING ASS'Y
APP'D BY 96/3/8 尺度 M.FUKUSHIMA SCALE 4 - 1		DR. CHK. DATE		REV B

角度 ANGLE	±3°	B	変更 REVISED	(JC60607)	96/3/8
30以上 OVER	±0.3	A	変更 REVISED	(T90386)	95/12/8
10以上 OVER	±0.25	O	新規作成 RELEASED		95/10/30
未満 UNDER	±0.2		記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK. DATE
一般公差 GENERAL TOLERANCES					

REVISE ONLY ON CAD SYSTEM

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX/JAPAN AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION  
本図面は日本モレックス(株)の所有する情報を含むもので 当社の許可なく複製を禁止する。

MXJ-8